

# 「2020 Moldex3D 全球模流達人賽」

## 活動說明書

### 一、活動宗旨

為提升大專學生對於模流分析技術之了解與應用技能，本校與科盛科技股份有限公司合作辦理 2020 Moldex3D 全球模流達人賽，希冀透過競賽激發學生開發創新的模流分析應用技巧及方法，促進理論與實務接軌，協助塑膠工程相關領域培育更多智慧製造人才。

### 二、參賽資格

參賽者須為經教育部核准之全國大專校院在學學生及碩、博士生（含應屆畢業生），可以個人或團隊名義參賽，團隊成員上限為 4 人（不含主管或是指導教授），每人限報名一個團隊。

### 三、競賽辦法：

競賽係以 Moldex3D 模流分析軟體進行實作案例分析，以「我的虛實整合之旅」為題，完成作品概念書及完整報告，參賽作品須以使用 Moldex3D 解決方案為主，並呈現應用 Moldex3D 帶來的具體效益，參賽作品內容如不符規定或繳交檔不完整者，不得評選，參賽團隊（者）不得異議。

### 四、報名方式：

- 競賽須自行於活動官網進行報名，報名時間為即日起至 109 年 6 月 20 日（星期六）止。網址為 <https://www.moldex3d.com/ch/events/industry-events/2020-moldex3d-global-innovation-talent-award/>。
- 文件繳交方式：所有檔案須於 2020 年 7 月 31 日（五）前寄至：[talentawards@moldex3d.com](mailto:talentawards@moldex3d.com)。
- 如檔案超過郵件附件限制，請將檔案上傳至網路空間後，提供下載連結。

### 五、競賽期程：

競賽期程	日期	說明
報名與概念書繳交	2020 年 6 月 20 日（六）前	完成線上報名及繳交作品概念書
收件審查	2020 年 7 月 31 日（五）前	參賽者繳交完整作品報告（包含授權同意書）
得獎公告	2020 年 9 月下旬	公告得獎名單

### 六、評選標準：

項目	評分比重
實務價值	40%
Moldex3D 應用技巧	30%
創意表現	20%
文件說明完整性與相關性	10%

加分項目：凡繳交 CAD 模型、幾何檔案(.stl 檔或.step 檔)及.3dm 檔或.mdg 檔，可以獲得作品加分！

## 七、獎勵辦法：

競賽以企業組及學生組作區分，個別選出組內首獎、二獎、三獎，特別獎將從兩組中擇優選出。首獎發給獎金 6,000 元美金，二獎發給獎金 4,000 元美金，三獎發給獎金 2,000 元美金，特別獎發給獎金 800 元美金。

科盛科技股份有限公司補助獲獎團隊「Moldex3D 全球技術研討會(MTC)」門票及西班牙 2 晚住宿(每隊雙床房乙間)，獎金頒發及住宿補助以團隊為單位作業。

因受新冠肺炎影響，MTC2020 取消，然而得獎權益不變，改為提供 MTC 2021 門票及住宿補助。

## 八、注意事項：

1. 所有參賽作品及繳交的檔案，主辦單位皆視為可公開資料，並將使用於行銷推廣用途。參賽(者)團體須保證繳交的資料並無機密或侵害他人著作權。作品提交後，即視為授權于科盛科技股份有限公司(科盛科技)及其分公司，科盛科技及其分公司得將繳交作品不限載體、用途、使用次數、地區、期間，包含但不限於散佈、重制、發行、改作、翻譯、再授權、公開傳輸、公開展示、公開播送與公開發表。
2. 以上比賽日期及時間、獎項內容和比賽規則及辦法，主辦單位有異動之權利，若有異動，將於官方網站公告，請參賽者密切注意。
3. 有關完整競賽規則及辦法，請至網頁查詢，網址：  
[https://www.moldex3d.com/en/assets/2019/11/Official\\_Rules\\_and\\_Regulations\\_GITA\\_2020.pdf](https://www.moldex3d.com/en/assets/2019/11/Official_Rules_and_Regulations_GITA_2020.pdf)。